

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Hongguang Holdings Limited

中國宏光控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8646)

自願公告

業務最新發展

關於廣東隆光完成TGV玻璃基覆銅板製造工藝企業標準備案

本公告由中國宏光控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願發佈，以向本公司股東及潛在投資者提供本集團在新材料核心技術領域的最新進展。本公告不構成根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條項下之強制披露，亦不構成對本集團未來盈利或股價表現的任何預測或保證。

備案背景

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本集團間接全資附屬公司廣東隆光新材料科技有限公司(「廣東隆光」)作為標準起草單位，主導編製的《一種TGV玻璃基覆銅板製造工藝》企業標準(標準編號：Q/LG 001-2026)，已完成企業標準資訊公共服務平台備案程式。該標準於二零二二年七月一日發佈，定於二零二六年七月一日正式實施。

本標準由廣東隆光提出並負責起草及解釋，主要起草人為Jiyong Li，標準文本涵蓋產品結構、材料組分、製備工藝及檢驗規範，適用於高頻毫米波通信、先進晶片封裝及車載電子等高端應用場景。

核心技術指標與產業突破

該標準所規範的產品及工藝，在以下維度形成差異化技術壁壘：

技術指標	標準參數	行業對比優勢
玻璃基帶厚度	30 μm –100 μm (柔性規格 30 μm –50 μm)	傳統GCC為硬質單片， 本標準實現卷材化
介電損耗(DF)	≤ 0.0007 @ 30GHz	顯著優於市面常規玻璃基板 (DF>0.002)
熱膨脹係數(CTE)	≤ 2.3 ppm/ $^{\circ}\text{C}$	適配高階晶片封裝熱管理 要求
最小彎折半徑	12mm (柔性規格)	可捲繞加工，裁切廢料降 低約65%
TGV微孔孔徑	25 μm –45 μm ，錐度72°–78°	成型階段同步預製，無需 鐳射二次打孔
鍍層剝離強度	≥ 1.2 N/mm (260 $^{\circ}\text{C}$ 回流焊不分層)	滿足SMT高溫製程可靠性
量產良品率	$\geq 93\%$	較傳統工藝(<72%)大幅提升
綜合成本降幅	較傳統工藝下降約32%	具備規模化量產經濟性

工藝創新要點

- 採用全電熔爐熔融+鉑金溢流連續成帶技術，實現玻璃基材的卷對卷(Roll-to-Roll)連續生產；
- TGV微孔一體成型：在玻璃溢流成型工序同步預製導通微孔，省去鐳射鑽孔環節，規避崩邊、裂紋及孔壁空洞風險；
- 梯度複合金屬層：TiCr納米阻擋層→薄銅過渡層→加厚電解銅層→OSP防氧化保護層，形成錨定結構，確保高溫高濕環境下的介面可靠性。

市場應用前景與戰略意義

該標準所覆蓋的TGV玻璃基覆銅板(Glass Core Copper Clad Laminate, GCC)，乃下一代高頻高速電子基材的關鍵材料，主要下游應用包括：

1. 車載毫米波雷達：適配77GHz頻段，滿足自動駕駛系統對低損耗、低膨脹基材的嚴苛要求；
2. 6G相控陣天線：超低介電損耗支撐毫米波信號低衰減傳輸；
3. Chiplet/2.5D/3D封裝：低CTE特性匹配矽晶片熱膨脹曲線，降低封裝翹曲風險；
4. CPO (共封裝光學)：為光電共封裝模組提供高頻基板解決方案。

董事會認為，本次企業標準備案的完成，標誌著廣東隆光在TGV玻璃基覆銅板領域已建立自主智慧財產權體系及可量產的工藝規範，有助於：

- 技術壁壘固化：以企業標準形式確立工藝參數及品質基準，為後續申請行業標準、國家標準及國際專利佈局提供底層支撐；
- 客戶認證加速：標準化生產體系有助於下游半導體封裝、通信設備廠商縮短供應商導入週期；
- 產能擴張合規化：為廣東隆光後續產線建設、供應鏈授信安排及資本運作提供技術合規依據；
- 本集團估值支撐：強化本集團在新材料硬科技賽道的資產含金量，契合本集團「新材料+」長期戰略佈局。

風險提示與免責條款

股東及潛在投資者務請注意以下事項：

1. 標準備案並不等於即時收入：企業標準備案屬於技術合規性程式，不代表相關產品已實現大規模量產或已簽署確定性銷售訂單，實際商業化進度取決於下遊客戶認證、產能建設及市場開拓情況；
2. 技術反覆運算風險：新材料行業技術路線反覆運算迅速，若後續出現替代性技術方案，可能對本標準所規範產品的市場競爭力產生影響；
3. 產能爬坡不確定性：從標準確立到產線投產、良品率穩定達標存在時間週期，期間可能面臨設備調試、工藝優化及原材料供應等不確定因素；
4. 市場風險：下游應用(如6G通信、Chiplet封裝)的產業化進度受全球宏觀經濟、行業政策及技術演進影響，存在市場釋放節奏不及預期的風險；
5. 本公告不構成要約：本公告所載資訊僅供投資者參考，不構成任何投資建議、要約或要約邀請。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，注意投資風險。

承董事會命
中國宏光控股有限公司
主席兼執行董事
林偉珊

香港，二零二六年八月四日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士及李婉娜女士；以及獨立非執行董事為毛淑娥女士、賈小剛先生及吳勇先生。

本公告資料乃遵照**GEM**上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.hongguang.hk。